

고순도 Ptfе 습식 세정 플라워 바스켓 단일 웨이퍼 에칭 랙 맞춤형 4인치 마스크 플레이트 캐리어

품목 번호: PL-CP66



소개

고순도 PTFE 습식 세정 플라워 바스켓은 반도체 웨이퍼 공정을 위한 탁월한 내화학성을 제공합니다. 이 맞춤형 에칭 랙은 까다로운 실험실 및 산업 환경에서 민감한 기판을 위한 오염 없는 침지 세정 및 핸들링을 보장합니다. 맞춤형 불소중합체 솔루션을 위해 당사에 문의하십시오.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
반도체 웨이퍼 세정	유기 및 금속 오염물질을 제거하기 위한 RCA 세정(SC-1 및 SC-2) 순서에서 실리콘 웨이퍼 침지.	교차 오염을 방지하고 고순도 공정을 보장합니다.
습식 화학 에칭	고온에서 불산 또는 인산 용액을 사용한 박막(SiO ₂ , Si ₃ N ₄)의 정밀 에칭.	공격적인 산 환경에서 구조적 무결성을 유지합니다.
마스크 플레이트 처리	결함 없는 패턴 전사를 보장하기 위해 리소그래피에 사용되는 포토마스크의 전문 핸들링 및 세정.	정밀 슬롯 가공으로 마스크 표면의 접촉-유발 손상을 방지합니다.
태양전지 제조	텍스처링 및 인산 실리케이트 글래스(PSG) 제거를 위한 실리콘 웨이퍼 대량 처리.	대량 생산 사이클에서 높은 처리량과 내구성.
전도성 유리 준비	광전자 및 디스플레이 제조를 위한 ITO/FTO 코팅 유리 세정 및 준비.	최소 접촉점으로 민감한 전도성 층의 긁힘을 방지합니다.
MEMS 개발	복잡한 회생층 에칭 공정 중 다중 마이크로 전자 기계 시스템 핸들링.	화학적 불활성으로 인해 미세 구조물이 손상되지 않습니다.
실험실 규모 R&D	신소재 개발을 위한 학술 및 산업 연구에서 소량 기판 처리.	다양한 맞춤형로 비표준 기판 형상 및 크기가 가능합니다.

매개변수	사양 세부사항 (모델: PL-CP66)
재료 구성	100% 고순도 순수 PTFE (폴리테트라플루오로에틸렌)
최대 작동 온도	+260°C (연속)
최소 작동 온도	-200°C
화학적 호환성	보편적 (pH 0-14); HF, 아쿠아 레지아, 피라냐 용액에 저항
표준 기판 크기	4인치 (100mm) - 모든 직경에 맞춤 가능
슬롯 구성	단일 웨이퍼 또는 다중 웨이퍼 변형 가능
슬롯 깊이/너비	기판 두께 및 안정성 요구 사항에 완전히 맞춤 가능
핸들 설계	고정 수직형, 탈부착형 또는 스윙 스타일 핸들 (맞춤형)
제작 방법	정밀 CNC 가공 (제로 성형 오염)
표면 마감	고광택, 저기공률 가공 마감